

**IEC 60191-6-18**  
(First edition – 2010)

**MECHANICAL STANDARDIZATION OF  
SEMICONDUCTOR DEVICES –**

**Part 6-18: General rules for the preparation of  
outline drawings of surface mounted  
semiconductor device packages –  
Design guide for ball grid array (BGA)**

**CEI 60191-6-18**  
(Première édition – 2010)

**NORMALISATION MÉCANIQUE DES DISPOSITIFS  
À SEMICONDUCTEURS –**

**Partie 6-18: Règles générales pour la préparation  
des dessins d'encombrement des dispositifs à  
semiconducteurs pour montage en surface –  
Guide de conception pour les boîtiers matriciels  
à billes (BGA)**

## **CORRIGENDUM 1**

### **3.1 ball grid array BGA**

*Instead of:*

"a package that has ..."

*read:*

"package that has ..."

### **3.1 NOTE**

*Instead of:*

"...(See Annex A)."

*read:*

"...(See Bibliography)."

### **3.2 plastic ball grid array P-BGA**

*Instead of:*

"BGA with an organic substrate"

*read:*

"BGA with a rigid organic substrate"

### **3.1 boîtier matriciel à billes BGA**

*à la place de:*

"un boîtier dont les billes métalliques..."

*lire:*

"boîtier dont les billes métalliques..."

### **3.1 NOTE**

*à la place de:*

"...(Voir Annexe A)."

*lire:*

"...(Voir Bibliographie)."

### **3.2 boîtier matriciel à billes en plastique P-BGA**

*à la place de:*

"boîtier BGA comportant un substrat  
organique"

*lire:*

"boîtier BGA comportant un substrat  
organique rigide"